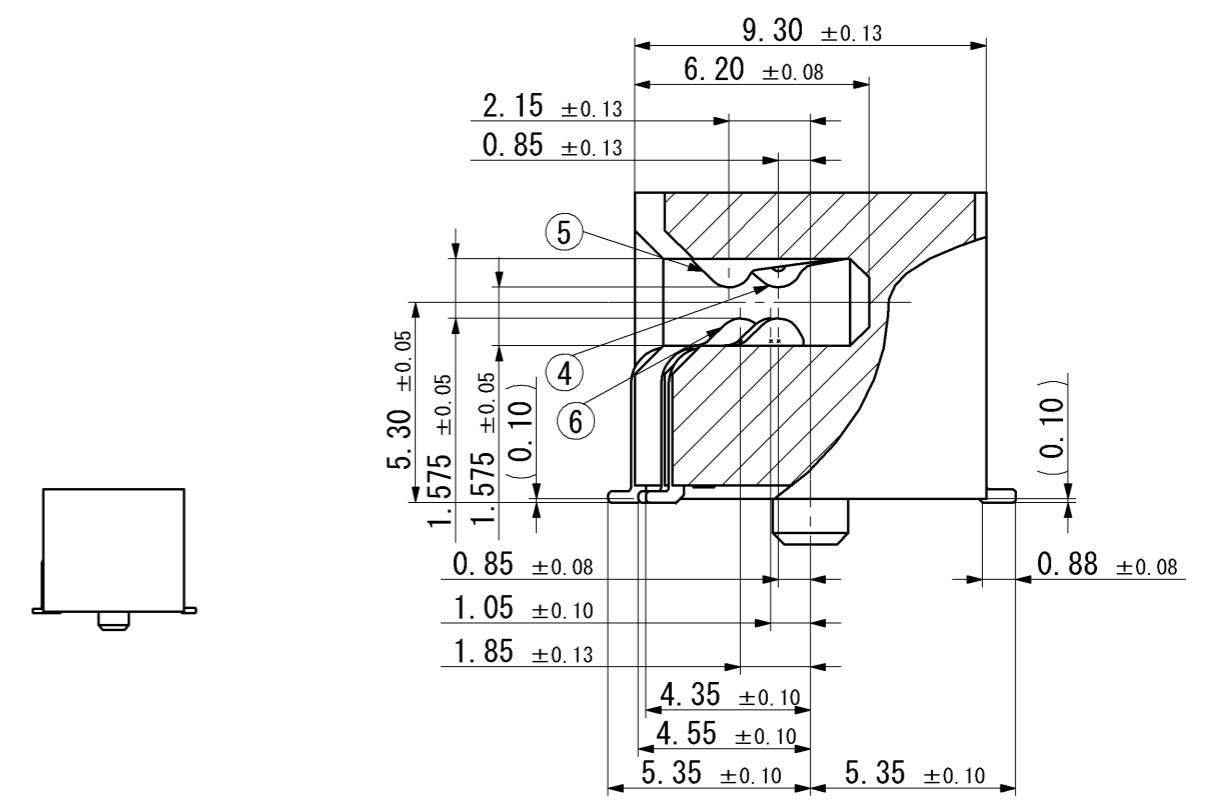
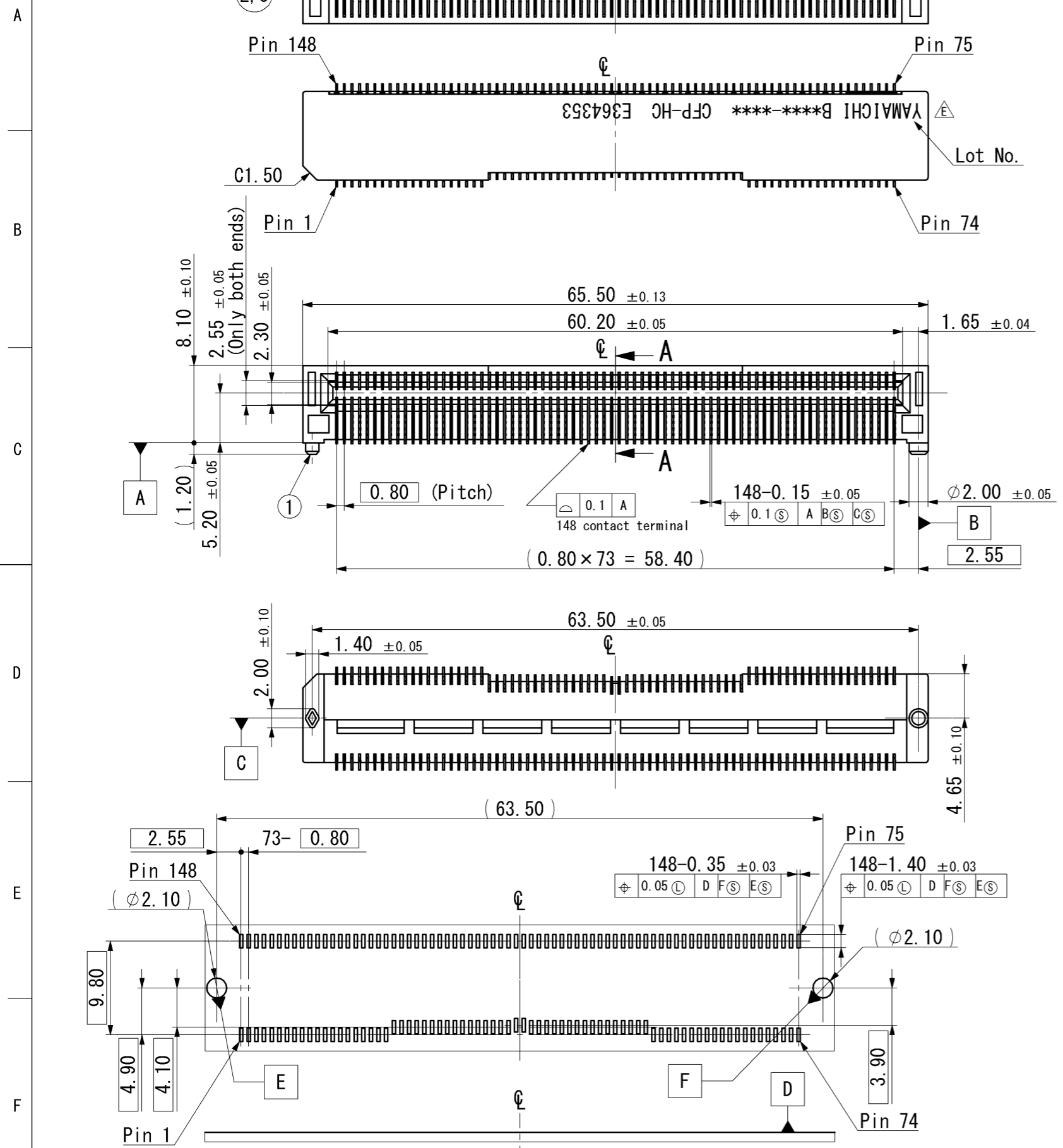


記号x数	変更内容 REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年月日	変更通知書No.
△ x 3	めっき仕様変更	伊東	吉田	笠井	10/05/13	M121155
△ x 11	Pin No. 追加、材質追記	伊東	吉田	池上	11/01/05	M122245
△ x 1	誤記訂正	伊東	吉田	池上	11/01/17	M122286
△ x 2	刻印追加 印字表記変更	伊東	佐藤	池上	13/10/01	M126919
△ x						



- 記事 NOTE
- 性能・取り扱いは、仕様書 F110170-001 による。
Refer to Specification F110170-001 for performance and handling.
 - 標準梱包はトレイとする。(梱包仕様書 R110170-001)
Standard packaging shall be Tray packing.
Refer to Packaging Spec. R110170-001 for details.
 - Lot No. Lot No. : YAMAICHI B****-****

Serial No.
Date of manufacture
Revision
(Drawing will be revised when the design changed)

部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT
6	下側コンタクト(Lower contact)	74	PB t0.18	Ni-NiPd-Au
5	上側グランドコンタクト(Upper Ground contact)	26	PB t0.18	Ni-NiPd-Au
4	上側シグナルコンタクト(Upper Signal contact)	48	PB t0.18	Ni-NiPd-Au
3	金具押さえ(Metal parts holder)	1	LCP	BLACK
2	金具(Metal parts)	2	PB t0.10	Ni-Au
1	インシュレータ(Insulator)	1	LCP(UL94V-0)	BLACK

推奨プリント基板寸法
RECOMMENDED PCB LAYOUT

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
()寸法は参考値 () Reference value.

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類 (CLASS) CFP-Host Connector
名称 (TITLE) CA009-S001-001
図番 (DRW. NO.) A110170-001

承認	承認	検図	製図	設計
APP.	APP.	CHK.	DRW.	DSGN.
伊東	吉田	笠井	笠井	

Scale: 2/1
Unit: mm
3RD. ANGLE PROJECTION